



- 產品特性 -

具導熱性
高耐電壓值
高機械強度

- Product Features -

Thermal conductivity
High dielectric strength
High mechanical strength

- 應用範圍 -

IC, CPU, GPU, MOS, LED, M/B, PSU, PS, Heat Sink, LCD-TV, CASE, NB, PC, HDD, DDR Module, etc.

- Application Area -

料號	P/N	FB-25	HP-1500	HP-2000	HP-3500	Unit	Test Method
背膠	Adhesive-backed	可 Yes	不可 No	不可 No	不可 No	-	-
自黏性	Self-Adhesive	無 No	有 Yes	有 Yes	有 Yes	-	-
厚度	Thickness	(Contact Sales)	0.2~0.5	0.2~0.5	0.2	mm	ASTM D374
導熱係數	Thermal Conductivity	1.3	1.5	2.2	3.5	W/mk	Hot Disk
熱阻	Thermal Resistance	-	0.48	0.28	0.2	°C-in ² /W	ASTM D5470
比重	Specific Gravity	2	2.4	27	2.9	g/cm ³	ASTM D792
延展率	Elongation	<1	< 10	< 10	< 10	%	ASTM D412
抗拉強度	Tensile Strength	50	> 21	> 21	> 21	Kgf/cm ²	ASTM D412
抗拉強度	Tensile Strength	711	> 300	> 300	> 300	psi	ASTM D412
硬度	Hardness	70±5	80	75	80	Shore A	ASTM D2240
重量損失	Weight Loss	< 1	-	-	-	%	200°C (48hrs)
介電常數	Dielectric Constant	-	6	7	8	1	ASTM D150
體積電阻率	Volume Resistivity	10 ¹⁷	> 10 ¹³	> 10 ¹³	> 10 ¹³	ohm•cm	ASTM D257
耐電壓	Insulation Strength	- / > 4.5 / > 6.5	> 3.5	> 3.5	> 3.5	KV	ASTM D149
耐溫範圍	Continuous Use Temp	-45~ 200	-50~220	-50~220	-50~220	°C	-

- 建議常溫常濕存放。
- 背膠產品請半年內使用完畢，保持黏著度。
- 可裁切和沖型客製尺寸。

Store in stable, standard conditions.
Use adhesive products within six months.
Custom cutting available as needed.